2026年10月22日

各　位

会 社 名　品川リフラ株式会社
代表者名　代表取締役社長　藤原　弘之
（コード番号5351　東証プライム、札証）
問合せ先　IR・広報部長　仮屋崎　勉
（TEL. 03－6265－1600）

半導体関連分野をはじめとする成長市場の需要拡大に対応した設備投資に関するお知らせ
～国内生産拠点の能力増強により供給体制を強化～

品川リフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原弘之、以下「当社」）は、半導体関連分野をはじめとする成長市場の需要拡大に対応するため、グループ会社を含む国内生産拠点における生産能力増強に向けた設備投資を決定しました。

今回の投資では、半導体製造装置向けファインセラミックス部品の焼成・精密加工能力を強化するとともに、グループ会社のイソライト工業株式会社（以下「イソライト工業」）において、半導体関連分野をはじめとした先端産業分野で需要が拡大する高機能断熱材の生産能力を増強します。これにより、成長市場における需要を着実に取り込み、安定供給体制のさらなる強化を図ります。

記

１．設備投資の背景

AIの普及などを背景に半導体市場が拡大する中、半導体製造装置に使用されるファインセラミックスの需要が増加しています。当社においても、ファインセラミックスの高精度加工部品需要が拡大しており、これに対応するため、生産能力の増強を進めます。

また、半導体関連分野をはじめとした先端産業分野では、生産プロセスの高温環境下で使用される高機能断熱材の需要が拡大しています。こうした需要拡大に対応し、高品質な製品を安定的に供給するため、イソライト工業において当該製品の生産能力の増強を進めます。

当社グループでは、こうした市場環境の変化を成長機会と捉え、生産基盤を強化していきます。

２．設備投資の概要

セクター・事業部門	投資拠点	投資内容	主な目的	投資額
先端機材セクター ファインセラミックス事業部門	備前工場	高温焼成炉の増設	半導体製造装置向けセラミックスの焼成能力増強	約２億円
	瀬戸内工場	高精度加工設備の新設	半導体製造装置向けセラミックスの高精度加工能力増強	約３億円
断熱材セクター	イソライト工業	PCW*成形・焼成設備の増強	高機能断熱材の生産能力増強	約3.5億円

＊PCW（Polycrystalline Wool：多結晶質繊維）：アルミナを主成分とする耐熱性に優れた人造鉱物繊維で、高温環境下で使用される工業炉などの断熱材として用いられています。

３．各設備投資の内容

（１）先端機材セクター ファインセラミックス事業部門における生産能力の増強

先端機材セクター ファインセラミックス事業部門では、半導体製造装置向けファインセラミックス部品の需要拡大に対応するため、備前工場および瀬戸内工場の生産能力を増強します。

① 備前工場における高温焼成炉の増設

備前工場では、半導体製造装置向けを中心とするファインセラミックスの需要拡大に対応するため、高温焼成シャトル炉を増設します。これにより焼成能力を倍増し、安定供給体制を強化します。投資額は約２億円で、2027 年７月の稼働開始を予定しています。

② 瀬戸内工場における高精度加工設備の新設

半導体製造装置向け高精度加工部品の需要増加を見据え、瀬戸内工場に精密加工設備を増設します。これにより、生産・供給能力を確保するとともに、内製化を進め、技術・生産基盤を強化します。投資額は約３億円で、2027 年４月の稼働開始を予定しています。

（２）断熱材セクター イソライト工業における PCW 生産能力の増強

イソライト工業では、半導体関連分野をはじめとした先端産業分野における高機能断熱材の需要拡大に対応するため、PCW 成形品の成形・焼成設備を増強します。本投資により PCW 成形品の生産能力を大幅に増強し、需要拡大への対応と安定供給体制の強化を図ります。投資額は約 3.5 億円で、2027 年７月の稼働開始を予定しています。

４．今後について

当社グループは、セラミックス（耐火物、断熱材およびファインセラミックス等）に関する材料・製造・加工技術を強みとして、既存事業の競争力強化に加え、半導体関連分野をはじめとした成長市場への事業展開を進めています。

今後も、市場環境やお客様のニーズの変化を的確に捉え、成長が期待される分野への設備投資を進めることで、生産基盤の強化と安定供給体制の構築を図り、持続的な成長につなげてまいります。

以 上